

2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年11月14日

上場会社名 ウィンテスト株式会社 上場取引所 東  
コード番号 6721 URL https://www.wintest.co.jp/  
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 姜 輝  
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部長 （氏名） 鎌田 文明 TEL 045-317-7888  
配当支払開始予定日 —  
決算補足説明資料作成の有無： 無  
決算説明会開催の有無： 無

（百万円未満切捨て）

1. 2025年12月期第3四半期の連結業績（2025年1月1日～2025年9月30日）

（1）連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）

|                | 売上高 |       | 営業利益 |   | 経常利益 |   | 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 |   |
|----------------|-----|-------|------|---|------|---|----------------------|---|
|                | 百万円 | ％     | 百万円  | ％ | 百万円  | ％ | 百万円                  | ％ |
| 2025年12月期第3四半期 | 270 | △25.4 | △623 | — | △621 | — | △644                 | — |
| 2024年12月期第3四半期 | 362 | 37.5  | △404 | — | △402 | — | △411                 | — |

（注）包括利益 2025年12月期第3四半期 △665百万円（－％） 2024年12月期第3四半期 △396百万円（－％）

|                | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|----------------|-----------------|----------------------------|
|                | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2025年12月期第3四半期 | △12.21          | —                          |
| 2024年12月期第3四半期 | △9.44           | —                          |

（注）2025年12月期第3四半期及び2024年12月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（2）連結財政状態

|                | 総資産   | 純資産 | 自己資本比率 |
|----------------|-------|-----|--------|
|                | 百万円   | 百万円 | ％      |
| 2025年12月期第3四半期 | 1,112 | 726 | 65.3   |
| 2024年12月期      | 1,195 | 699 | 57.0   |

（参考）自己資本 2025年12月期第3四半期 726百万円 2024年12月期 681百万円

2. 配当の状況

|               | 年間配当金  |        |        |      |      |
|---------------|--------|--------|--------|------|------|
|               | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |
|               | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  |
| 2024年12月期     | —      | 0.00   | —      | 0.00 | 0.00 |
| 2025年12月期     | —      | 0.00   | —      |      |      |
| 2025年12月期（予想） |        |        |        | 0.00 | 0.00 |

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2025年12月期の連結業績予想（2025年1月1日～2025年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

|    | 売上高 |   | 営業利益 |   | 経常利益 |   | 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 |   | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|-----|---|------|---|------|---|---------------------|---|----------------|
|    | 百万円 | ％ | 百万円  | ％ | 百万円  | ％ | 百万円                 | ％ | 円 銭            |
| 通期 | —   | — | —    | — | —    | — | —                   | — | —              |

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

2025年12月期の連結業績予想につきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示します。詳細については、添付資料P3「1. 経営成績等の概況 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| ② ①以外の会計方針の変更        | : 無 |
| ③ 会計上の見積りの変更         | : 無 |
| ④ 修正再表示              | : 無 |

(4) 発行済株式数（普通株式）

|                     |               |             |               |             |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 2025年12月期 3 Q | 53,641,000株 | 2024年12月期     | 45,059,100株 |
| ② 期末自己株式数           | 2025年12月期 3 Q | 一株          | 2024年12月期     | 一株          |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 2025年12月期 3 Q | 52,765,850株 | 2024年12月期 3 Q | 43,641,000株 |

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また、上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料2ページ「1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況」をご覧ください。

○添付資料の目次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況 .....                  | 2  |
| (1) 当四半期の経営成績の概況 .....             | 2  |
| (2) 当四半期の財政状態の概況 .....             | 2  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....    | 3  |
| (4) 継続企業の前提に関する重要事象等 .....         | 4  |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....           | 6  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 6  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ..... | 8  |
| 四半期連結損益計算書                         |    |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 8  |
| 四半期連結包括利益計算書                       |    |
| 第3四半期連結累計期間 .....                  | 9  |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....        | 10 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 10 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 14 |
| (四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) .....    | 14 |
| (セグメント情報等の注記) .....                | 14 |

## 1. 経営成績等の概況

### （1）当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結会計期間（2025年7月1日～2025年9月30日）における世界半導体市場は、SEMI（国際半導体製造装置材料協会）の発表によれば、2025年の世界半導体製造装置市場は1,255億米ドルに達し、過去最高を更新する見通しとなっております。成長の主な要因は、生成AIやデータセンター向けを中心とした先端ロジック及び高帯域メモリ（HBM）関連への投資拡大によるものです。

一方で、当社が主に扱う非AI分野向け半導体製造装置市場は、パソコン、スマートフォン、一般産業機器などの需要低迷が続いており、依然として厳しい事業環境にあります。同業他社においても非AI領域では受注の減少や設備稼働率の低下が見られ、当社もその影響を受けております。

同SEMIによりますと、2025年には、後工程（バックエンド）分野全体で、テスト装置が前年比23.2%増の93億米ドル、パッケージング装置が7.7%増の54億米ドルと回復が見込まれております。しかしながら、これらの成長は主にAI関連投資によるものであると考えられております（同AI関連投資に関しましても、下半期から2026年にかけて、活況を呈するAI分野への投資もやがて落ち着きを見せるのではとの予測もあります）。

それでは、当社が扱う非AI分野向け半導体検査装置市場に関して見通しが暗いのかということ、そうではなく、2025年下期以降は新機能を搭載したスマートフォンや次世代PCの需要も活発化し、徐々に非AI市場も上向くことが予想されております。当社の主力市場である民生・産業向け分野には直接的な波及が限定的ですが、今まで落ち込んでいた民生、産業エリアにおいても2026年に向け徐々に活況を取り戻すものと予想されております。

当社市場領域においては、一時落ち着きを見せるかと思われた米国トランプ政権の関税政策等、日毎に変わるような状況であり、世界が揺さぶられている状況ですが、地政学的な状況を勘案してもなお、現状においては、半導体の製造工場数や製造量で中国市場を無視できない状況です。当社としては、中国国内に子会社を有するという地政学的な優位性を活かし、2025年下期そして2026年に向けた市場拡大に即応できる受注力・製造体制の強化を最重要課題として推進してまいります。

当社は今まで、その時々課題解決のため、2023年1月13日に第11回新株予約権の発行を決議し、装置製造に関わる半導体、特に米国製ハイエンド部材の仕入等の目的として433,338千円の資金調達を行いました。また、2023年9月15日には、第三者割当による新株式の発行を決議し、399,912千円の資金調達を行い次世代装置のパリエーション展開、SoC検査装置の参入準備（マーケティング、基礎技術導入費用等）を行っております。2024年の12月のセミコンショーでは、悲願であった次世代高精度高速検査システムWTS-577SX、WTS-9000などの次世代装置を完成させリリースを行いました。

しかしながら、上述のとおり顧客工場における新規設備投資は想定以上に遅れが発生、年初から当第3四半期に至り新規システムへのお引き合いは頂くことが出来、現在多くのお客様にて装置のベンチマーク（導入に向けた製造能力評価）をさせて頂いておりますが、受注から売上計上までに時間を要しており、当該期間における業績は低調に推移しました。

上述のような状況を打破するため、非半導体エリアでの新規事業を事業化し推進することとし、2024年10月31日に第12回新株予約権の発行を決議し、GFA株式会社（現ABC株式会社）を割当先として調達した資金によって、それまで水面下で進めていた3新事業並びにパワー半導体向け検査装置など本格的に予算を付け進めてまいりました。当該新規事業である「IoTヘルスケア装置、ボディービートセンサー」、「自重補償機構による荷役用簡易エレベータ機器」の製品化及びSDGsに配慮した「アルカリイオン洗浄水生成装置」の量産準備を整え第4四半期中には販売の開始が見込める状況となりました。

当社は、今後の戦略として上述のように当社が得意とする一部の市場動向に業績が大きく左右されることのない事業環境に挑むべく、既存の民生、産業エリア半導体市場向け検査装置に加えて、新たな事業を社内にて立上げ、一部エリアの半導体市場動向に左右されない会社の体制を作り事業の安定化を計画し、第4四半期後半から準備を開始してまいります。

この結果、当第3四半期連結累計期間の当社グループの売上高は270,308千円（前年同四半期比25.4%減）、営業損失623,400千円（前年同四半期は営業損失404,228千円）、経常損失621,150千円（前年同四半期は経常損失402,435千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失644,425千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失411,986千円）となりました。

### （2）当四半期の財政状態の概況

#### （資産）

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ82,118千円減少し、1,089,274千円（前連結会計年度末比7.0%減）となりました。この主な要因は、現金及び預金が98,276千円増加、売掛金が29,047千円増加、商品及び製品が78,734千円増加したものの、原材料及び貯蔵品が254,337千円減少、仕掛品が29,533千円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ482千円減少し、23,425千円（前連結会計年度末比2.0%減）となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が482千円減少したことによるものです。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ92,277千円減少し、284,355千円（前連結会計年度末比24.5%減）となりました。この主な要因は、買掛金が46,434千円増加したものの、短期借入金が100,000千円減少、未払金が22,282千円減少、契約負債が15,116千円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ16,531千円減少し、102,208千円（前連結会計年度末比13.9%減）となりました。この主な要因は、資産除去債務が8,684千円増加したものの、長期借入金が24,465千円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ26,207千円増加し、726,136千円（前連結会計年度末比3.7%増）となりました。この主な要因は、資本金と資本準備金がそれぞれ355,238千円増加したものの、利益剰余金が644,425千円減少、為替換算調整勘定が21,007千円減少、新株予約権が18,837千円減少したことによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

EE Times・WSTS（世界半導体市場統計）から引用すると、2025年の半導体市場は2024年後半から続くAI関連半導体（GPU：並列情報処理チップ、HBM：ハイバンドメモリー）の爆発的な需要に支えられ大きく伸長しました。しかし、非AI関連の民生向け或いは産業向け（車載半導体、パワー半導体など）半導体市場は、地政学リスクや経済の不透明感から弱含みで推移し、2025年下半年においても未だ新規設備投資は限定的な状況が続いております。当社は、主にDDICなどの民生向け半導体の検査装置をお客様に提供しており、当第3四半期の受注状況は上述のような市況の波を強く受けることとなりました。特に当社がメイン市場としている台湾、中国における新規設備投資は依然として様子見の状況が続いております。しかしながら、各お客様工場の稼働率は第4四半期以降徐々に上向いており、工場システムの稼働率も上昇傾向にあることから、新規設備投資に関する計画もお客様から少しずつ聞こえてくるなど前向きな状況となりつつあります。

当社グループが「主力装置」と位置付けるディスプレイ・ドライバIC検査装置は、液晶パネルに使われるディスプレイ・ドライバIC（ディスプレイに絵や文字を表示するIC）の検査に使用されており、また、それら情報機器ではディスプレイ・ドライバICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーICと検査用高精度光源装置（TOF機能搭載）、制御用ロジックICなど多種にわたる周辺半導体デバイスが使われております。現状、足元では上述のように新規設備投資は足踏み状態が続いておりますが、中期的には需要も戻り更に大きな伸びが期待される分野です。

当社市場領域においては、一時落ち着きを見せるかと思われた米国トランプ政権の関税政策等、日毎に変わるような状況であり、世界が揺さぶられている状況ですが、地政学的な状況を勘案してもなお、現状においては、半導体の製造工場数や製造量で中国市場を無視できない状況です。当社としては引き続き中国半導体市場をメインターゲットとした販売戦略を推し進めてまいります。しかしながら、上述のような状況から現在当社が得意とする民生向け半導体検査装置など一部の市場動向に業績が大きく左右されることのない事業環境構築が必要不可欠と考えました。

そこで当社は、既存の後工程領域の事業エリアに加えて、新しく2026年の早いうちに前工程領域への事業エリアを拡大する予定でおります。現在当社の主たる事業分野は、半導体の後工程（ウエーハ検査も含め）に特化した事業となっております。半導体工程は前の工程に行けば行くほど汎用性が広く、後の工程に行けば行くほど専門性が高く狭い市場となります。当社は半導体検査装置の中でもDDIC向け検査装置と汎用ロジック検査装置を主軸としており、広い市場とは言えません。前工程はどのような半導体を製造するにあたって、必ず通る工程であり、前工程領域は、半導体市場が一部落ち込むことが有っても比較的市場が安定していると考えられ、当社の業績の安定にも繋がると考えております。本件の詳細につきましては、決定次第速やかに開示させていただきます。

また、当社の100%中国製造子会社「偉恩測試技術（武漢）有限公司」（以下、「ウインテスト武漢」という。）に関しまして、営業・製造体制の見直しを進め、中国・台湾において、グループ力による受注を強化します。また、営業とアフターサポートセクションである「テスト技術部」との情報共有を促進し、より顧客に寄り添った営業活動を図ってまいります。工場運営では、現地出張を含む積極的な日本からの応援を行い、顧客対応力（クレーム解決力）の強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

当第3四半期までの当社業績は上述のような理由から、受注は低迷いたしました。今後民生・産業向け半導体市場の回復が見込まれる中、遅れを取ることをないようにハイエンド主力検査装置「WTS-577SX」並びに普及版の「WTS-577SR」、そしてフラッグシップとなる3,500チャンネル越えの能力を持つ「WTS-9000」を主軸として市場攻略を続けてまいります。

先端ロジック半導体検査装置に搭載される先進機能（I/O 1024チャンネル、デジタルスピード1.6Gbps）に関し次世代LCDデータキャプチャーボードとともに2026年度上半期中には販売の開始を計画しております。また、引き続き次世代向け機能として超高速デジタルパターンスピード発生装置USDRとして4.0Gbpsを発生する高速ソースの開発は継続中ですが、2026年夏までには開発を終了し、顧客への提供を開始する予定です。

パワー半導体向け検査装置の市場は一時的なEV離れにより停滞気味ですが、中長期的には、今後とも安定的な

伸びが期待できる分野です。2024年11月に「第12回第三者割当増資」で調達した資金の一部を使い、2026年末を目途にパワー半導体検査装置の設計と開発に日々邁進しております。

国内市場に目を向けると、汎用デジタル市場の検査分野、そして2027年までにデバイス検査の新たなアプローチとして注目の集まるSLT（システムレベルテスト）に対応する検査装置の開発を有力顧客との連携のもとに進めてまいります。

特許である自重補償機構技術（以下「MGC技術」）を使ったトラック用テールゲートリフターについては、慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、2025年10月26日（日）に富士スピードウェイで開催された「ジャパントラックショー2025」に実機の展示を行い同時に多くのご来場者皆様に体験型のデモを実施し、複数の大手架装企業様から協業のご提案も頂くことができました。なお、詳細につきましては、2025年10月29日付でお知らせいたしました「「ジャパントラックショー in Fujispeedway 2025」出展のご報告」をご参照ください。本装置は、昨年話題となった2024年問題で揺れる「物流業界」において、主流となっているテールゲートパワーリフター（重量物荷役補助装置）に代えて、モーターや高価な油圧機構を利用せず安価に利用できる荷役装置としての実用化を行なったものです。今後、MGC技術を使った昇降機能付き台車の製品化、介護やその他の荷役作業用途への展開を考えております。

株式会社TAOS研究所と連携のもと進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、バイタルセンサー部分に新型のものを採用し改善を行い、検査精度の向上、分析機能の改善改良に加えてPCやタブレット並びにスマートフォン向けのアプリケーションの改善も進めております。改善された機能は、ソフトウェアアップデートを通じてお買い上げいただいたお客様に提供されます。現在、10数セットの試作量産を終了し、本格量産を行います。ただし、当初は生産数量の関係があるため、販売方法に関しましては一部の有力代理店を通じた販売方式を考えております。

次に当社独自で進めておりました水素ナノバブルイオン洗浄水製造装置に関しましては、2025年6月19日付「株式会社レドックステクノロジーとの開発協業開始のお知らせ」にてお知らせいたしましたように、同社の特許技術が入った高性能電解槽を当社装置に使った新バージョンに移行し、大幅に精製能力と洗浄水の品質の向上を図ることができました。現在製造体制（量産）の整備を計画しており、遅くとも当第4半期中には販売の開始を行います。

2025年7月17日付「先端技術を駆使した液体レンズ「RYUGU」正式販売開始のお知らせ」で販売の開始をいたしました液体レンズ「RYUGU」は、6月11日から3日間開催された「画像センシング展 2025」にて先行展示を行い100社越えに上るご来場者の皆様から、大きな反響をいただきました。その後、2025年9月25日にお知らせしました、「SSDM（国際固体素子・材料コンファレンス）2025」展示会に出展し多くの学術関係者の皆様にご来場いただきました。これは従来のガラスなどで作られるレンズに代えて特殊な液体を組み合わせたレンズ構造とし、プログラムされた電圧を加えることで厚さ（焦点）を瞬時に制御できる製品となります。現在全国各地の大学からお引き合い、ご注文を頂いており、順次出荷をしております。

「WTS-CT130」マイクロCT、X線照射3D断層撮影検査装置に関しまして、2024年12月のセミコンショー、そして上述のSSDM2025に出展、多くの顧客からデモのご依頼を受けました。また国内新規取り扱い代理店との契約を行なうことができました。販売の加速が期待されます。なお、デモ機は当社横浜本社に常設展示されており、ご要望を頂いたお客様立合いのもと、お客様「持込み試料」について、実際にエックス線撮像による3Dデモを実施しております。

なお、2025年2月14日の「2024年12月期 決算短信」で公表いたしましたとおり、2025年12月期の連結業績予想につきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示します。

#### （4）継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度において、半導体のダブつきと民生半導体の需要減による工場稼働率の低迷が長引いたことの影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高は417,090千円となりました。また、資産の健全性を確保するために棚卸資産の評価損を計上したことに伴い、売上原価が増加し、営業損失1,083,829千円、経常損失は1,094,080千円、親会社株主に帰属する当期純損失1,105,888千円を計上いたしました。

前連結会計年度においては、AI関連半導体が集中する米州が前年比45.2%増と突出した成長となり、1,951億2,300万米ドルに達したのにひきかえ、非AI領域市場に偏重する日本を含むアジア、欧州の成長は前年比8.1%減と伸び悩みました。この状況を受け当社の注力する中国・台湾市場においては、多くの半導体製造工場で生産調整から新規設備投資を凍結しておりました。

当第3四半期会計期間（2025年1月1日～2025年9月30日）におけるSEMI（国際半導体製造装置材料協会）の発表によれば、2025年の世界半導体製造装置市場は1,255億米ドルに達し、過去最高を更新する見通しとなっております。成長の主な要因は、生成AIやデータセンター向けを中心とした先端ロジック及び高帯域メモリ（HBM）関連への投資拡大によるものです。

一方で、当社が主に取り扱う非AI分野向け半導体製造装置市場は、パソコン、スマートフォン、一般産業機器

や車載向けなどの需要低迷が続いており、依然として厳しい事業環境にあります。同業他社においても非AI領域では受注の減少や設備稼働率の低下が見られ、当社もその影響を受けております。

同SEMIによりますと、2025年には、後工程（バックエンド）分野全体で、テスト装置が前年比23.2%増の93億米ドル、パッケージング装置が7.7%増の54億米ドルと回復が見込まれております。しかしながら、これらの成長は主にAI関連投資によるものであると考えられております（同AI関連投資に関しましても、下半期から2026年にかけて、活況を呈するAI分野への投資もやがて落ち着きを見せるのではとの予測もあります）。

それでは、当社が取り扱う非AI分野向け半導体検査装置市場に関して見通しが暗いのかということ、そうではなく、2025年下期以降は新機能を搭載したスマートフォンや次世代PCの需要も活発化し、徐々に非AI市場も上向くことが予想されており、今まで落ち込んでいた民生、産業エリアにおいても2026年に向け徐々に活況を取り戻すものと予想されております。

当社を取り巻く経済情勢は、一時落ち着きを見せるかと思われた米国トランプ政権の関税政策などにより、日毎に変わるような状況であり、世界が揺さぶられておりますが、地政学的な状況を勘案してもなお、現状においては、半導体の製造工場数や製造量で中国市場は無視できない存在です。当社としては、中国国内に子会社を有するという優位なポジションを活かし、2025年下期そして2026年に向けた市場拡大に即応できる受注力・製造体制の強化を最重要課題として推進してまいります。

以上より、当第3四半期連結累計期間の売上高は270,308千円にとどまり、営業損失623,400千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を644,425千円計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループでは、こうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しましては、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）」に記載しております。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

（1）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

|               | 前連結会計年度<br>(2024年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2025年9月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部          |                          |                              |
| 流動資産          |                          |                              |
| 現金及び預金        | 90,703                   | 188,979                      |
| 受取手形          | 291                      | 599                          |
| 売掛金           | 88,595                   | 117,643                      |
| 電子記録債権        | —                        | 775                          |
| 商品及び製品        | 33,534                   | 112,269                      |
| 仕掛品           | 597,773                  | 568,240                      |
| 原材料及び貯蔵品      | 316,844                  | 62,507                       |
| 前渡金           | 2,618                    | 3,998                        |
| 未収消費税等        | 26,620                   | 21,092                       |
| その他           | 14,410                   | 13,169                       |
| 流動資産合計        | 1,171,393                | 1,089,274                    |
| 固定資産          |                          |                              |
| 有形固定資産        |                          |                              |
| 建物            | 8,182                    | 16,777                       |
| 減価償却累計額       | △8,182                   | △16,777                      |
| 建物（純額）        | —                        | —                            |
| 車両運搬具         | 8,885                    | 8,885                        |
| 減価償却累計額       | △8,885                   | △8,885                       |
| 車両運搬具（純額）     | —                        | —                            |
| 工具、器具及び備品     | 181,952                  | 181,952                      |
| 減価償却累計額       | △181,952                 | △181,952                     |
| 工具、器具及び備品（純額） | —                        | —                            |
| 有形固定資産合計      | —                        | —                            |
| 投資その他の資産      |                          |                              |
| その他           | 23,908                   | 23,425                       |
| 投資その他の資産合計    | 23,908                   | 23,425                       |
| 固定資産合計        | 23,908                   | 23,425                       |
| 資産合計          | 1,195,301                | 1,112,700                    |

（単位：千円）

|               | 前連結会計年度<br>(2024年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2025年9月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                          |                              |
| 流動負債          |                          |                              |
| 買掛金           | 100,526                  | 146,961                      |
| 短期借入金         | 100,000                  | —                            |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,064                   | 32,064                       |
| 未払金           | 90,980                   | 68,698                       |
| 未払法人税等        | 2,476                    | 205                          |
| 契約負債          | 28,023                   | 12,907                       |
| その他           | 22,560                   | 23,518                       |
| 流動負債合計        | 376,632                  | 284,355                      |
| 固定負債          |                          |                              |
| 長期借入金         | 104,902                  | 80,437                       |
| リース債務         | 7,228                    | 6,477                        |
| 資産除去債務        | 6,609                    | 15,294                       |
| 固定負債合計        | 118,740                  | 102,208                      |
| 負債合計          | 495,372                  | 386,563                      |
| <b>純資産の部</b>  |                          |                              |
| 株主資本          |                          |                              |
| 資本金           | 1,674,419                | 2,029,658                    |
| 資本剰余金         | 1,960,905                | 2,316,144                    |
| 利益剰余金         | △3,129,016               | △3,773,441                   |
| 株主資本合計        | 506,308                  | 572,361                      |
| その他の包括利益累計額   |                          |                              |
| 為替換算調整勘定      | 174,782                  | 153,775                      |
| その他の包括利益累計額合計 | 174,782                  | 153,775                      |
| 新株予約権         | 18,837                   | —                            |
| 純資産合計         | 699,928                  | 726,136                      |
| 負債純資産合計       | 1,195,301                | 1,112,700                    |

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
（四半期連結損益計算書）  
（第3四半期連結累計期間）

（単位：千円）

|                     | 前第3四半期連結累計期間<br>（自 2024年1月1日<br>至 2024年9月30日） | 当第3四半期連結累計期間<br>（自 2025年1月1日<br>至 2025年9月30日） |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 売上高                 | 362,429                                       | 270,308                                       |
| 売上原価                | 216,109                                       | 369,349                                       |
| 売上総利益               | 146,319                                       | △99,040                                       |
| 販売費及び一般管理費          | 550,547                                       | 524,360                                       |
| 営業損失（△）             | △404,228                                      | △623,400                                      |
| 営業外収益               |                                               |                                               |
| 受取利息                | 133                                           | 461                                           |
| 為替差益                | 9,014                                         | —                                             |
| 補助金収入               | —                                             | 2,337                                         |
| スクラップ売却益            | —                                             | 1,846                                         |
| その他                 | 1,584                                         | 626                                           |
| 営業外収益合計             | 10,732                                        | 5,272                                         |
| 営業外費用               |                                               |                                               |
| 支払利息                | 8,160                                         | 2,507                                         |
| 支払手数料               | 517                                           | 490                                           |
| その他                 | 262                                           | 23                                            |
| 営業外費用合計             | 8,940                                         | 3,021                                         |
| 経常損失（△）             | △402,435                                      | △621,150                                      |
| 特別利益                |                                               |                                               |
| 新株予約権戻入益            | —                                             | 8,702                                         |
| 特別利益合計              | —                                             | 8,702                                         |
| 特別損失                |                                               |                                               |
| 減損損失                | 7,686                                         | 30,058                                        |
| 特別損失合計              | 7,686                                         | 30,058                                        |
| 税金等調整前四半期純損失（△）     | △410,122                                      | △642,506                                      |
| 法人税、住民税及び事業税        | 1,864                                         | 1,919                                         |
| 法人税等調整額             | —                                             | —                                             |
| 法人税等合計              | 1,864                                         | 1,919                                         |
| 四半期純損失（△）           | △411,986                                      | △644,425                                      |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △411,986                                      | △644,425                                      |

（四半期連結包括利益計算書）

（第3四半期連結累計期間）

（単位：千円）

|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>（自 2024年1月1日<br>至 2024年9月30日） | 当第3四半期連結累計期間<br>（自 2025年1月1日<br>至 2025年9月30日） |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 四半期純損失（△）       | △411,986                                      | △644,425                                      |
| その他の包括利益        |                                               |                                               |
| 為替換算調整勘定        | 15,778                                        | △21,007                                       |
| その他の包括利益合計      | 15,778                                        | △21,007                                       |
| 四半期包括利益         | △396,207                                      | △665,432                                      |
| （内訳）            |                                               |                                               |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △396,207                                      | △665,432                                      |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | —                                             | —                                             |

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当社グループは、前連結会計年度において、半導体のダブつきと民生半導体の需要減による工場稼働率の低迷が長引いたことの影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高は417,090千円となりました。また、資産の健全性を確保するために棚卸資産の評価損を計上したことに伴い、売上原価が増加し、営業損失1,083,829千円、経常損失は1,094,080千円、親会社株主に帰属する当期純損失1,105,888千円を計上いたしました。

前連結会計年度においては、AI関連半導体が集中する米州が前年比45.2%増と突出した成長となり、1,951億2,300万米ドルに達したのにひきかえ、非AI領域市場に偏重する日本を含むアジア、欧州の成長は前年比8.1%減と伸び悩みました。この状況を受け当社の注力する中国・台湾市場においては、多くの半導体製造工場で生産調整から新規設備投資を凍結しておりました。

当第3四半期会計期間（2025年1月1日～2025年9月30日）におけるSEMI（国際半導体製造装置材料協会）の発表によれば、2025年の世界半導体製造装置市場は1,255億米ドルに達し、過去最高を更新する見通しとなっております。成長の主な要因は、生成AIやデータセンター向けを中心とした先端ロジック及び高帯域メモリ（HBM）関連への投資拡大によるものです。

一方で、当社が主に扱う非AI分野向け半導体製造装置市場は、パソコン、スマートフォン、一般産業機器や車載向けなどの需要低迷が続いており、依然として厳しい事業環境にあります。同業他社においても非AI領域では受注の減少や設備稼働率の低下が見られ、当社もその影響を受けております。

同SEMIによりますと、2025年には、後工程（バックエンド）分野全体で、テスト装置が前年比23.2%増の93億米ドル、パッケージング装置が7.7%増の54億米ドルと回復が見込まれております。しかしながら、これらの成長は主にAI関連投資によるものであると考えられております（同AI関連投資に関しましても、下半期から2026年にかけて、活況を呈するAI分野への投資もやがて落ち着きを見せるのではとの予測もあります）。

それでは、当社が扱う非AI分野向け半導体検査装置市場に関して見通しが暗いのかというと、そうではなく、2025年下期以降は新機能を搭載したスマートフォンや次世代PCの需要も活発化し、徐々に非AI市場も上向くことが予想されております。当社の主力市場である民生・産業向け分野には直接的な波及が限定的ですが、今まで落ち込んでいた民生、産業エリアにおいても2026年にかけて徐々に活況を取り戻すものと予想されております。

当社を取り巻く経済情勢は、一時落ち着きを見せるかと思われた米国トランプ政権の関税政策などにより、日毎に変わるような状況であり、世界が揺さぶられておりますが、地政学的な状況を勘案してもなお、現状においては、半導体の製造工場数や製造量で中国市場は無視できない存在です。当社としては、中国国内に子会社を有するという優位なポジションを活かし、2025年下期そして2026年に向けた市場拡大に即応できる受注力・製造体制の強化を最重要課題として推進してまいります。

以上より、当第3四半期連結累計期間の売上高は270,308千円にとどまり、営業損失623,400千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を644,425千円計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

事業施策

1. 中国国内での受注販売活動の促進

2024年度大きく期待された半導体市場の回復はAI関連の大きな躍進が目立ちましたが、上述のように当社が所属する「非AI領域」は力強さが無く低迷いたしました。2025年下半期となった今日現在においても設備投資動向は依然として様子見が続けており、当第3四半期末までの期間では受注売上の回復は叶いませんでした。SEMI（国際半導体製造装置材料協会）の発表によれば、2025年の世界半導体製造装置市場は1,255億米ドルに達し、過去最高を更新する見通しとなっております。成長の主な要因は、生成AIやデータセンター向けを中心とした先端ロジック及び高帯域メモリ（HBM）関連への投資拡大によるものです。

一方で、当社が主に扱う非AI分野向け半導体製造装置市場は、パソコン、スマートフォン、一般産業機器などの需要低迷が続いており、依然として厳しい事業環境にあります。同業他社においても非AI領域では受注の減少や設備稼働率の低下が見られ、当社もその影響を色濃く受けております。

同SEMIによりますと、2025年には、後工程（バックエンド）分野全体で、テスト装置が前年比23.2%増の93億米ドル、パッケージング装置が7.7%増の54億米ドルと回復が見込まれております。しかしながら、これらの成長は主にAI関連投資によるものであると考えられております（同AI関連投資に関しましても、下半期から2026年にかけて、活況を呈するAI分野への投資もやがて落ち着きを見せるのではとの予測もあります）。

それでは、当社が扱う非AI分野向け半導体検査装置市場に関して見通しが暗いのかというと、そうではなく、2025年下期以降は新機能を搭載したスマートフォンや次世代PCの需要も活発化し、徐々に非AI市場も上向くことが予想されております。当社の主力市場である民生・産業向け分野には直接的な波及が限定的ですが、今まで落

ち込んでいた民生、産業エリアにおいても2026年にかけて徐々に活況を取り戻すものと予想されております。

当社市場領域においては、一時落ち着きを見せるかと思われた米国トランプ政権の関税政策等、日毎に変わるような状況であり、世界が揺さぶられている状況ですが、地政学的な状況を勘案してもなお、現状においては、半導体の製造工場数や製造量で中国市場を無視できない状況です。当社としては、中国国内に子会社を有するという地政学的な優位性を活かし、2025年下期そして2026年に向けた市場拡大に即応できる受注力・製造体制の強化を最重要課題として推進してまいります。

当社は今まで、その時々課題解決のため、2023年1月13日に第11回新株予約権の発行を決議し、装置製造に関わる半導体、特に米国製ハイエンド部材の仕入等の目的として433,338千円の資金調達を行いました。また、2023年9月15日には、第三者割当による新株式の発行を決議し、399,912千円の資金調達を行い次世代装置のバリエーション展開、SoC検査装置の参入準備（マーケティング、基礎技術導入費用等）を行っております。2024年の12月のセミコンショーでは、悲願であった次世代高精度高速検査システムWTS-577SX、WTS-9000などの次世代装置を完成させリリースを行いました。

しかしながら、上述のとおり顧客工場における新規設備投資は想定以上に遅れが発生、年初から当第3四半期に至り新規システムへのお引き合いは頂くことが出来、現在多くのお客様にて装置のベンチマーク（導入に向けた製造能力評価）をさせて頂いておりますが、受注から売上計上までに時間を要しており、当該期間における業績は低調に推移しました。

上述のような状況を打破するため、非半導体エリアでの新規事業を事業化し推進することとし、2024年10月31日に第12回新株予約権の発行を決議し、GFA株式会社（現abc株式会社）を割当先として調達した資金によって、それまで水面下で進めていた3新事業並びにパワー半導体向け検査装置など本格的に予算を付け進めてまいりました。当該新規事業である「IoTヘルスケア装置、ボディービートセンサー」、「自重補償機構による荷役用簡易エレベータ機器」の製品化及びSDGsに配慮した「アルカリイオン洗浄水生成装置」の量産準備を整え第4四半期中には販売の開始が見込める状況となりました。

当社は、今後の戦略として上述のように当社が得意とする一部の市場動向に業績が大きく左右されることのない事業環境に挑むべく、既存の民生、産業エリア半導体市場向け検査装置に加えて、新たな事業を社内にて立上げ、一部エリアの半導体市場動向に左右されない会社の体制を作り事業の安定化を計画し、第4四半期後半から準備を開始してまいります。

当社市場領域においては、一時落ち着きを見せるかと思われた米国トランプ政権の関税政策等、日毎に変わるような状況であり、世界が揺さぶられている状況ですが、地政学的な状況を勘案してもなお、現状においては、半導体の製造工場数や製造量で中国市場を無視できない状況です。当社としては引き続き中国半導体市場をメインターゲットとした販売戦略を推し進めてまいります。しかしながら、上述のような状況から現在当社が得意とする民生向け半導体検査装置など一部の市場動向に業績が大きく左右されることのない事業環境構築が必要不可欠と考えました。

そこで当社は、既存の後工程領域の事業エリアに加えて、新しく2026年の早いうちに前工程領域への事業エリアを拡大する予定であります。現在当社の主たる事業分野は、半導体の後工程（ウエーハ検査も含め）に特化した事業となっております。半導体工程は前の工程に行けば行くほど汎用性が広く、後の工程に行けば行くほど専門性が高く狭い市場となります。当社は半導体検査装置の中でもDDIC向け検査装置と汎用ロジック検査装置を主軸としており、広い市場とは言えません。前工程はどのような半導体を製造するにあたって、必ず通る工程であり、前工程領域は、半導体市場が一部落ち込むことが有っても比較的市場が安定していると考えられ、当社の業績の安定にも繋がると考えております。本件の詳細につきましては、決定次第速やかに開示させて頂きます。

また、当社の100%中国製造子会社「偉恩測試技術（武漢）有限公司」（以下、「ウインテスト武漢」という。）に関しまして、営業・製造体制の見直しを進め、中国・台湾において、グループ力による受注を強化します。また、営業とアフターサポートセクションである「テスト技術部」との情報共有を促進し、より顧客に寄り添った営業活動を図ってまいります。工場運営では、現地出張を含む積極的な日本からの応援を行い、顧客対応力（クレーム解決力）の強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

当第3四半期までの当社業績は上述のような理由から、受注は低迷いたしました。今後民生・産業向け半導体市場の回復が見込まれる中、遅れを取ることもないようハイエンド主力検査装置「WTS-577SX」並びに普及版の「WTS-577SR」、そしてフラッグシップとなる3,500チャンネル越えの能力を持つ「WTS-9000」を主軸として市場攻略を続けてまいります。

## 2. 技術開発の強化

先端ロジック半導体検査装置に搭載される先進機能（I/O 1024チャンネル、デジタルスピード1.6Gbps）に関し次世代LCDデータキャプチャボードとともに2026年度上半期中には販売の開始を計画しております。また、引き続き次世代向け機能として超高速デジタルパターンスピード発生装置USDRとして4.0Gbpsを発生する高速リソースの

開発は継続中ですが、2026年夏までには開発を終了し、顧客への提供を開始する予定です。

パワー半導体向け検査装置の市場は一時的なEV離れにより停滞気味ですが、中長期的には、今後とも安定的な伸びが期待できる分野です。2024年11月に「第12回第三者割当増資」で調達した資金の一部を使い、2026年末を目途にパワー半導体検査装置の設計と開発に日々邁進しております。

国内市場に目を向けると、汎用デジタル市場の検査分野、そして2027年までにデバイス検査の新たなアプローチとして注目の集まるSLT（システムレベルテスト）に対応する検査装置の開発を有力顧客との連携のもとに進めてまいります。

### 3. 隣接領域の展開と製品化

特許である自重補償機構技術（以下「MGC技術」）を使ったトラック用テールゲートリフターについては、慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、2025年10月26日（日）に富士スピードウェイで開催された「ジャパントラックショー2025」に実機の展示を行い同時に多くのご来場者皆様に体験型のデモを実施し、複数の大手架装企業様から協業のご提案も頂くことができました。なお、詳細につきましては、2025年10月29日付でお知らせいたしました「「ジャパントラックショー in Fujispeedway 2025」出展のご報告」をご参照ください。本装置は、昨年に話題となった2024年問題で揺れる「物流業界」において、主流となっているテールゲートパワーリフター（重量物荷役補助装置）に代えて、モーターや高価な油圧機構を利用せず安価に利用できる荷役装置としての実用化を行なったものです。今後、MGC技術を使った昇降機能付き台車の製品化、介護やその他の荷役作業用途への展開を考えております。

株式会社TAOS研究所と連携のもと進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、バイタルセンサー部分に新型のものを採用し改善を行い、検査精度の向上、分析機能の改善改良に加えてPCやタブレット並びにスマートフォン向けのアプリケーションの改善も進めております。改善された機能は、ソフトウェアアップデートを通じてお買い上げいただいたお客様に提供されます。現在、10数セットの試作量産を終了し、本格量産を行います。ただし、当初は生産数量の関係があるため、販売方法に関しましては一部の有力代理店を通じた販売方式を考えております。

次に当社独自で進めておりました水素ナノバブルイオン洗浄水製造装置に関しましては、2025年6月19日付「株式会社レドックステクノロジーとの開発協業開始のお知らせ」にてお知らせいたしましたように、同社の特許技術が入った高性能電解槽を当社装置に使った新バージョンに移行し、大幅に精製能力と洗浄水の品質の向上を図ることができました。現在製造体制（量産）の整備を計画しており、遅くとも当第4半期中には販売の開始を行います。

2025年7月17日付「先端技術を駆使した液体レンズ「RYUGU」正式販売開始のお知らせ」で販売の開始をいたしました液体レンズ「RYUGU」は、6月11日から3日間開催された「画像センシング展 2025」にて先行展示を行い100社越えに上るご来場者の皆様から、大きな反響をいただきました。その後、2025年9月25日にお知らせしました、「SSDM（国際固体素子・材料コンファレンス）2025」展示会に出展し多くの学術関係者の皆様にご来場いただきました。これは従来のガラスなどで作られるレンズに代えて特殊な液体を組み合わせたレンズ構造とし、プログラムされた電圧を加えることで厚さ（焦点）を瞬時に制御できる製品となります。現在全国各地の大学からお引き合い、ご注文を頂いており、順次出荷をしております。

「WTS-CT130」マイクロCT、X線照射3D断層撮影検査装置に関しまして、2024年12月のセミコンショー、そして上述のSSDM2025に出展、多くの顧客からデモのご依頼を受けました。また国内新規取り扱い代理店との契約を行なうことができました。販売の加速が期待されます。なお、デモ機は当社横浜本社に常設展示されており、ご要望を頂いたお客様立合いのもと、お客様「持込み試料」について、実際にエックス線撮像による3Dデモを実施しております。

### 財務施策

財務面については、事業拡張を考えた財務戦略として財務基盤を強化する目的のため、2024年10月31日付取締役会の決議において、GFA株式会社（現：abc株式会社）を割当先とする10,000千株の第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を決議し、同年11月20日付で第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了が行われ、順調に行使が進み2025年7月22日付で、すべての行使が完了、合計約8億円の調達をしております。なお、一部資金使途及び支出予定時期の見直しをしております。今後とも新規開発、営業並びに新規事業方面での資金需要を鑑み、機動的なファイナンスを計画するとともに有力半導体検査周辺機器メーカーやパワー半導体専門メーカーなどのM&Aも計画し、日本市場においても注目を集める検査分野への進出を目指し、資本提携や協力体制を積極的に進め、新規市場参入を加速し対応可能検査範囲の拡充、収益基盤固めに取り組んでまいります。

また新領域事業の開始など必要に応じ当社のグループ企業あるいは金融機関等からの借入や新規ファイナンスを計画し、事業成長に資する資金確保についての施策を継続的に検討実施してまいります。

しかしながら、事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けることから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、当四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映しておりません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第3四半期連結累計期間（自 2025年1月1日 至 2025年9月30日）

当社は、当第3四半期連結累計期間に、第三者割当の方法による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ355,238千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が2,029,658千円、資本剰余金が2,316,144千円となっております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

|       | 前第3四半期連結累計期間<br>（自 2024年1月1日<br>至 2024年9月30日） | 当第3四半期連結累計期間<br>（自 2025年1月1日<br>至 2025年9月30日） |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 減価償却費 | 269                                           | 8,595                                         |

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

当社グループは、「半導体検査装置事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。